

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6938852号
(P6938852)

(45) 発行日 令和3年9月22日(2021.9.22)

(24) 登録日 令和3年9月6日(2021.9.6)

(51) Int.Cl.

F 1

B24B	53/00	(2006.01)	B 24 B	53/00
B24B	5/35	(2006.01)	B 24 B	5/35
B24B	49/12	(2006.01)	B 24 B	49/12
B24B	49/18	(2006.01)	B 24 B	49/18
B24B	53/053	(2006.01)	B 24 B	53/053

A

請求項の数 5 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2016-91857(P2016-91857)
(22) 出願日	平成28年4月28日(2016.4.28)
(65) 公開番号	特開2017-196718(P2017-196718A)
(43) 公開日	平成29年11月2日(2017.11.2)
審査請求日	平成31年3月18日(2019.3.18)

(73) 特許権者	000001247 株式会社ジェイテクト 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地
(74) 代理人	110000648 特許業務法人あいち国際特許事務所
(74) 代理人	100130188 弁理士 山本 喜一
(74) 代理人	100089082 弁理士 小林 優
(74) 代理人	100190333 弁理士 木村 群司
(72) 発明者	森田 浩 大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号 株式会社ジェイテクト内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】研削盤

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

工作物を回転可能に支持する主軸台と、
前記工作物を研削する砥石車と、
前記砥石車をツルーアイングするツルアと、
前記工作物を表面粗さ検出対象物として、前記表面粗さ検出対象物の表面粗さを検出するセンサと、
前記砥石車に対するツルーアイングに関する制御を行う制御装置と、
を備え、
前記制御装置は、

前記砥石車に対するツルーアイングを実行するツルーアイング実行部と、
前記ツルーアイング実行部により前記砥石車に対するツルーアイングを行った直後に研削された前記工作物の表面粗さが、予め定めた基準表面粗さに到達しているか否かを判定する判定部と、
を備え、

前記ツルーアイング実行部は、前記判定部により前記工作物の表面粗さが前記基準表面粗さに到達していないと判定された場合に、前記砥石車に対するツルーアイングを再度実行する、研削盤。

【請求項 2】

前記センサは、前記工作物が前記主軸台に支持された状態で、前記工作物の表面粗さの

10

20

検出を行う、請求項 1 に記載の研削盤。

【請求項 3】

工作物を回転可能に支持する主軸台と、

前記工作物を研削する砥石車と、

前記砥石車をツルーアイングするツルアと、

前記砥石車のツルーアイング直後に前記砥石車により研削され、前記砥石車との接触により前記砥石車の外径を測定する接触検知ピンである判定対象物であって、前記砥石車に対するツルーアイングが適切に実行されたか否かの判定に用いられる判定対象物と、

前記判定対象物を表面粗さ検出対象物として、前記表面粗さ検出対象物の表面粗さを検出するセンサと、

前記砥石車に対するツルーアイングに関する制御を行う制御装置と、

を備え、

前記制御装置は、

前記砥石車に対するツルーアイングを実行するツルーアイング実行部と、

前記ツルーアイング実行部により前記砥石車に対するツルーアイングを行った直後に研削された前記判定対象物の表面粗さが、予め定めた基準表面粗さに到達しているか否かを判定する判定部と、

を備え、

前記ツルーアイング実行部は、前記判定部により前記判定対象物の表面粗さが前記基準表面粗さに到達していないと判定された場合に、前記砥石車に対するツルーアイングを再度実行する、研削盤。

【請求項 4】

前記センサは、

基板と、

前記基板上に装着され、前記表面粗さ検出対象物に向けて発光する発光素子と、

前記基板上において前記発光素子の近傍に装着され、前記表面粗さ検出対象物からの反射光を受光可能な受光素子と、

前記受光素子の受光量に基づいて前記表面粗さ検出対象物の表面粗さを演算する演算部と、

を備える、請求項 1 - 3 の何れか一項に記載の研削盤。

【請求項 5】

前記受光素子は、CCD 又は CMOS 素子であり、

前記演算部は、前記CCD 又は前記CMOS 素子による検出結果に基づき、前記表面粗さ検出対象物の表面粗さを演算する、請求項 4 に記載の研削盤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、研削盤に関する。

【背景技術】

【0002】

特許文献 1 には、砥石がドレッサに接触したときに砥石に発生する弾性波を検出し、検出した弾性波に応じた測定値に基づいて、砥石がドレッサに接触したか否かを判定する技術が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2010 - 30022 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

10

20

30

40

50

しかしながら、特許文献1に記載の技術は、ドレッシングを行う前に砥石及びドレッサの位置決めを行う技術であり、ドレッシング後においてドレッシングが適切に行われたか否かの確認に用いることはできない。

【0005】

本発明は、適切にツルーリングが実施されたことを確認できる研削盤を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の研削盤は、工作物を回転可能に支持する主軸台と、工作物を研削する砥石車と、砥石車をツルーリングするツルアと、工作物又は接触検知ピンである判定対象物の表面粗さを検出するセンサと、砥石車に対するツルーリングに関する制御を行う制御装置とを備える。制御装置は、砥石車に対するツルーリングを実行するツルーリング実行部と、砥石車に対するツルーリングを行った直後に研削した工作物又は接触検知ピンである判定対象物の表面粗さが、予め定めた基準表面粗さに到達しているか否かを判定する判定部を備える。ツルーリング実行部は、判定部により工作物又は判定対象物の表面粗さが基準表面粗さに到達していないと判定された場合に、砥石車に対するツルーリングを再度実行する。

10

【0007】

本発明の研削盤によれば、砥石車に対するツルーリングを行った直後に研削した工作物又は判定対象物の表面粗さが、予め定めた基準表面粗さに到達しているか否かを判定し、到達していないと判定された場合に砥石車を再度ツルーリングするので、砥石車に対して適切にツルーリングを実施できる。

20

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】本発明の第一実施形態における研削盤の平面図である。

【図2】センサ保持部に保持されたセンサ部の断面図である。

【図3】制御装置のブロック図である。

【図4】ツルーリング直前及びツルーリング直後における表面粗さの変化を示すグラフである。

【図5】ツルーリング制御部において実行されるツルーリング処理を示すフローチャートである。

30

【図6】第二実施形態における研削盤の平面図である。

【図7】ツルーリング直後に研削された接触検知ピンの端面の表面粗さを示すグラフである。

【図8】制御装置におけるツルーリング処理2において実行されるツルーリング処理2を示すフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0009】

<1. 第一実施形態>

(1 - 1. 研削盤1の概略構成)

40

以下、本発明に係る研削盤の実施形態について、図面を参照しながら説明する。まず、図1を参照して、本発明の一実施形態における研削盤1の概略構成について説明する。

【0010】

図1に示すように、研削盤1は、円筒状の工作物Wを回転させながら研削加工を行うテーブルトラバース型の研削盤である。研削盤1は、ベッド2と、テーブル10と、主軸台20と、心押台30と、砥石台40と、砥石車50と、ツルア60と、クーラント供給装置70と、定寸装置80と、エア供給装置90と、センサ100と、制御装置110とを備える。

【0011】

ベッド2は、研削盤1の基台となる部位である。ベッド2には、研削条件等に関する各

50

種パラメータが入力される操作盤3が設けられ、操作盤3は、作業者により操作される。テーブル10は、ベッド2上において、Z軸方向へ移動可能に設けられる。テーブル10は、Z軸モータ11を有するねじ送り装置12を駆動させることにより、Z軸方向へ往復移動する。

【0012】

主軸台20は、テーブル10上に固定される。主軸台20は、Z軸方向に平行な軸回りに回転する主軸21と、主軸21を回転させるための駆動力を付与する主軸モータ22とを備える。主軸台20は、主軸21により工作物Wの一端を回転可能に支持し、主軸モータ22により工作物Wを回転駆動する。心押台30は、テーブル10上において主軸台20と対向する位置に設けられ、工作物Wの他端を支持する。

10

【0013】

砥石台40は、ベッド2上においてX軸方向へ移動可能に設けられる。砥石台40は、X軸モータ41を有するねじ送り機構42を駆動させることにより、X軸方向へ往復移動する。砥石車50は、砥石台40に対し、Z軸方向に平行な軸回りに回転自在に支持される。砥石車50は、砥石台40に固定された砥石車モータ51から駆動力を付与されることで回転し、工作物Wの外周面を研削する。ツルア60は、主軸台20に対し、Z軸に平行な軸まわりに回転自在に支持される。ツルア60は、主軸台20に設けられたツルアモータ61から付与される駆動力により回転し、砥石車50のツルーリング（形状成形及び目立て）を行う。

【0014】

20

クーラント供給装置70は、ベッド2上に設けられる。クーラント供給装置70は、砥石台40に設けられたクーラントノズル（図示せず）を介して、研削部位にクーラントを供給する。定寸装置80は、テーブル10を挟んだ砥石車50の反対側において、工作物Wに接触可能に設けられる。定寸装置80は、砥石車50により研削された工作物Wの外径を計測する。

【0015】

エア供給装置90は、テーブル10を挟んだ砥石車50の反対側に設けられる。エア供給装置90は、工作物Wの加工領域へ向けて配置されたエア吹付部91を備え、エア吹付部91から工作物Wにエアを吹き付けることで、工作物Wの外周面に付着したクーラント等の付着物を除去する。なお、本実施形態では、工作物Wにエアを吹き付けているが、エアの代わりに、工作物Wに対する加工に影響を与えない不活性ガス等を吹き付けてもよい。

30

【0016】

センサ100は、テーブル10を挟んだ砥石車50の反対側において、X軸方向へ移動可能に設けられる。センサ100は、研削加工後の工作物Wのセンシングを行い、工作物Wの表面粗さを検出する。センサ100によるセンシングは、工作物Wに対する研削加工が終了した後、工作物Wが主軸台20及び心押台30に支持された状態で行う。従って、センサ100により工作物Wの表面粗さを検出した結果、再度のツルーリングが必要であると判定された場合には、砥石車50に対するツルーリングを、工作物Wの搬送と並行して行うことができる。即ち、加工後の工作物Wを別の場所へ搬送した後に工作物Wの表面粗さを検出し、その検出結果に基づいて再度のツルーリングを行う場合と比べて、工作物Wの研削加工が終了してから次の工作物Wの研削加工を開始するまでの時間の短縮を図ることができる。

40

【0017】

また、センサ100は、砥石車50による工作物Wの研削加工中において、工作物Wから離れた位置で待機し、研削加工が終了すると、工作物Wに近づく。これにより、研削加工中に飛散するクーラント等がセンサ100に付着することを防止できる。さらに、工作物Wの外周面に付着するクーラント等の付着物は、エア供給装置90から工作物Wに向けてエアを吹き付けることで除去される。よって、センサ100により工作物Wの外周面の表面粗さを検出するにあたり、その検出精度を高めることができる。

50

【0018】

(1 - 2 . センサ部101の構成)

次に、図2を参照して、センサ100の構成を説明する。図2に示すように、センサ100は、センサ部101と、センサ保持部102と、演算部103(図3参照)とを備える。なお、演算部103は、センサ100の内部に配置してもよく、センサ100の外部に配置し、ケーブル等によりセンサ保持部102に接続してもよい。

【0019】

センサ部101は、測定対象物である工作物Wの表面粗さを非接触で検出する。なお、センサ部101の詳細については後述する。センサ保持部102は、センサ部101を保持する部位であり、ベッド2(図1参照)上においてX軸方向へ移動可能に設けられる。演算部103は、センサ部101による検出結果に基づき、表面粗さを演算する。

10

【0020】

続いて、センサ部101について説明する。センサ部101は、基板104と、発光素子105と、第一受光素子106及び第二受光素子107と、蓋部108と、3つのレンズ108a～108cとを備える。

【0021】

基板104は、半導体材料(N型、P型、バイポーラ型など)から構成され、センサ保持部102の一表面上(図2において下方を向く表面)上に装着される。発光素子105は、基板104に装着される発光ダイオードであり、センサ保持部102の一表面の法線方向(図2下方向)へ向けて発光する。第一受光素子106及び第二受光素子107は、基板104に装着されたフォトダイオードであり、発光素子105の近傍に配置される。発光素子105、第一受光素子106及び第二受光素子107は、センサ保持部102の長手方向(図2左右方向)に沿って直線状に並設され、発光素子105は、第一受光素子106と第二受光素子107との間に配置される。なお、基板104上に配置された発光素子105、第一受光素子106及び第二受光素子107は、仕切板109により仕切られている。従って、発光素子105からの発光及び第一受光素子106及び第二受光素子107への受光を効率的に行うことができる。

20

【0022】

また、本実施形態では、発光素子105として発光ダイオードを用いる場合を例に挙げて説明したが、発光ダイオードの代わりに、エレクトロルミネッセンスやレーザー素子等を発光素子105として用いてもよい。また、本実施形態では、第一受光素子106及び第二受光素子107としてフォトダイオードを用いる場合を例に挙げて説明したが、フォトダイオードの代わりに、CCDやCMOS素子等を第一受光素子106及び第二受光素子107として用いてもよい。

30

【0023】

蓋部108は、基板104、発光素子105、第一受光素子106及び第二受光素子107を覆う。蓋部108には、発光素子105、第一受光素子106及び第二受光素子107のそれぞれと対向する位置にレンズ108a～108cが一つずつ保持される。3つのレンズ108a～108cは、非球面レンズでもよく、検出し易くするためにレンズ形状を変更して、レンズの焦点位置や焦点深度を調整してもよい。

40

【0024】

3つのレンズ108a～108cのうち、発光素子105と対向する位置に配置されるレンズ108aには、発光素子105から照射される光が入射する。レンズ108aは、発光素子105から照射された光を屈曲させ、その屈曲させた光を特定の位置Pに導く。

【0025】

3つのレンズ108a～108cのうち、第一受光素子106及び第二受光素子107と対向する位置に配置されるレンズ108b, 108cは、特定の位置Pから入射する光を屈曲させ、その屈曲させた光を第一受光素子106又は第二受光素子107に導く。

【0026】

ここで、発光素子105から光を照射した場合、特定の位置Pにおける表面粗さが小さ

50

いほど光が散乱しにくいため、第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 により検出される光量が大きくなる。そして、演算部 103 は、発光素子 105 から光を照射した際に第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 が検出する光量に基づき、特定の位置 P における表面粗さの演算を行う。即ち、発光素子 105 から光を照射した場合、第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 が検出した光量が多ければ、表面粗さが小さいとの演算結果が示され、第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 が検出した光量が少なければ、表面粗さが大きいとの演算結果が示される。

【0027】

なお、実際には、特定の位置 P への入射光と特定の位置からの反射光は広がりを持っており、入射角及び反射角は角度の広がりを有する。従って、演算部 103 は、入射光の分布のうち、最も強度の強いピーク位置における入射角と、反射光の分布のうち、最も強度の高いピーク位置における反射角とが等しい場合、或いは、入射光の広がり分布と反射光の広がり分布とが相似関係にある場合に、入射角と反射角とが等しいと判断する。10

【0028】

このように、センサ部 101 は、工作物 W の表面粗さを非接触で検出することができる
ので、表面粗さの検出に伴って研削加工後の工作物 W に傷がつくことを回避できる。さら
に、センサ部 101 は、1 つの発光素子 105 から照射した場合に、特定の位置 P において
反射する反射光の変化を、2 つの受光素子（第一受光素子 106 及び第二受光素子 107）
で確認することができる。よって、高精度に工作物 W の表面粗さを測定することができる。20

【0029】

また、発光素子 105、第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 を1つの基板 104 に配置することで、発光素子 105、第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 を互いに近接した位置に配置できる。よって、発光素子 105、第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 を別々の基板に形成する場合と比べて、センサ部 101 の小型化を図ることができる。

【0030】

（1-3. 制御装置 110 について）

次に、図 3 を参照して、制御装置 110 について説明する。図 3 に示すように、制御装置 110 は、研削加工制御部 120 と、ツルーライング制御部 130 と、を備える。30

【0031】

研削加工制御部 120 は、工作物 W に対して行う研削加工に関する制御を行う。研削加工制御部 120 は、例えば、各種モータ（Z 軸モータ 111、主軸モータ 22、X 軸モータ 41、砥石車モータ 51）の駆動制御や、クーラント供給装置 70 から供給するクーラント量の制御、定寸装置 80 による工作物 W の径寸法の管理等を行う。研削加工制御部 120 は、1 つの工作物 W に対する研削加工が終了すると、研削加工が終了した旨の通知をツルーライング制御部 130 に対して行う。なお、研削加工制御部 120 は、工作物 W の搬送を行う搬送装置（図示せず）等に関する制御についても行う。

【0032】

ツルーライング制御部 130 は、砥石車 50 に対して行うツルーライングに関する制御を行う。ツルーライング制御部 130 は、ツルーライング実行部 131 と、判定部 132 と、基準表面粗さ設定部 133 と、を備える。40

【0033】

ツルーライング実行部 131 は、各種モータの駆動制御等を行うことにより、砥石車 50 とツルア 60（図 1 参照）との位置調整を行い、ツルア 60 による砥石車 50 のツルーライングを実行する。

【0034】

判定部 132 は、ツルーライングを行った後に最初に研削した工作物 W の表面粗さに基づき、ツルーライングが適切に実行されたか否かを判定する。判定部 132 は、ツルーライングが適切に実行されていないと判定した場合には、再度、ツルーライング実行部 131 に対し50

てツルーリングを実行するように指示する。

【0035】

基準表面粗さ設定部133には、ツルーリングが適切に実行されたか否かを判定部132が判定する際の基準となる表面粗さの値が設定されている。判定部132は、ツルーリング直後に研削した最初の工作物Wの表面粗さが、基準表面粗さ設定部133に設定された基準表面粗さSに到達しているかを判定する。

【0036】

ここで、図4を参照して、判定部132により実行される判定処理について、グラフを参照しながら説明する。図4に示す例では、ツルーリング後に研削した工作物Wの数が、予め定めた一定個数の到達した場合に、ツルーリングを実行する。

10

【0037】

図4に示すように、研削加工を重ねるにつれて砥石車の摩耗が進行するため、ツルーリング直前に研削した工作物Wの表面粗さは、ツルーリング直後に研削した工作物Wよりも大きくなる。

【0038】

そこで、ツルーリング後に研削した工作物Wの数が、予め定めた一定個数に到達した時点で、砥石車50に対するツルーリングを行う。そして、ツルーリングが適切に実行された場合には、ツルーリング直後に研削した最初の工作物Wの表面粗さの値Sが基準表面粗さSthの値まで回復する。この場合、次回のツルーリングの実行直前に研削する工作物Wについても、その工作物Wの表面粗さSは、工作物Wとして満たすべき表面粗さSmianの値を上回ると考えられる。

20

【0039】

しかしながら、ツルーリング時におけるツルア60と砥石車50との接触不良等の理由により、ツルーリングが適切に実行されない場合がある。この場合、ツルーリング直後に研削した最初の工作物Wの表面粗さの値Sは、基準表面粗さSthまで回復しない。この状態の砥石車50を用いて工作物Wの研削加工を継続すると、次回のツルーリングの実行直前に研削する工作物Wの表面粗さSが、工作物Wとして満たすべき基準表面粗さSmianを下回る可能性が高くなる。その結果、研削不良による不良品の発生個数が多くなる。

【0040】

これに対し、研削盤1では、ツルーリング直後に研削した最初の工作物Wに対し、センサ100によるセンシングを実行し、工作物Wの表面粗さを検出する。そして、その検出結果に基づき、判定部132は、ツルーリング直後に研削した最初の工作物Wの表面粗さの値Sが、基準表面粗さSth以上であるか否を判定する。その結果、ツルーリング直後に研削した最初の工作物Wの表面粗さの値Sが、基準表面粗さSth未満（不良）であると判定された場合には、再度、砥石車50に対するツルーリングを実行する。これにより、研削不良による不良品の発生個数を少なくすることができる。

30

【0041】

（1-4. ツルーリング制御部130での処理）

次に、図5を参照して、ツルーリング制御部130により実行されるツルーリング処理について、フローチャートを参照しながら説明する。図5に示すように、ツルーリング処理ではまず、ツルーリング実行の指示があったか否かを判定する（S1）。このS1による処理としては、例えば、最後にツルーリングを実行してから砥石車50が研削した工作物Wの数を計測し、砥石車50が研削した工作物Wの数が一定回数に到達した場合に、ツルーリング実行の指示があったと判定する処理を行う場合などが例示される。

40

【0042】

そして、ツルーリング実行の指示がなければ（S1：No）、S1の処理に戻る。これに対し、ツルーリング実行の指示があれば（S1：Yes）、ツルーリング実行部131は、ツルーリング実行処理を開始する（S2）。ツルーリング実行部131によるツルーリングが終了すると、研削加工制御部120による工作物Wの研削加工が開始される。

【0043】

50

S 3 の処理では、工作物Wの研削が終了したか否か、即ち、ツルーリング後に最初に研削する工作物Wについて、その工作物Wの研削加工が終了した否かを判定する。このS 3 の処理としては、例えば、工作物Wに対する研削加工が終了した旨の通知を研削加工制御部120から受けたか否かを判定する処理を行う場合などが例示される。

【0044】

その結果、工作物Wの研削が終了していないければ(S 3 : No)、S 3 の処理に戻る。一方、工作物Wの研削が終了した場合には(S 3 : Yes)、センサ100に対し、工作物Wのセンシング実行を指示する(S 4)。その後、センサ100から検出結果を受信したか否かの判定を行い(S 5)、受信していない場合には(S 5 : No)、S 5 の処理へ戻る。一方、センサから100から検出結果を受信した場合には(S 5 : Yes)、判定部132による判定処理、即ち、センサ100による検出結果に基づき、ツルーリング後に最初に研削した工作物Wの表面粗さの値Sが、基準表面粗さS thを満たすか否かを判定する処理が実行される(S 6)。10

【0045】

S 6 の処理の結果、工作物Wの表面粗さの値Sが基準表面粗さS thを満たすと判定した場合には(S 6 : Yes)、ツルーリングが適切に実行されたと判断できる。よってこの場合には、そのまま本処理を終了する。一方、S 6 の処理の結果、工作物Wの表面粗さの値Sが基準表面粗さS thを満たさないと判定した場合には(S 6 : No)、ツルーリングが適切に実行されなかったと判断できる。よってこの場合には、S 2 の処理へ戻り、再度、ツルーリングを実行する。20

【0046】

なお、S 6 の処理において、工作物Wの表面粗さの値Sが基準表面粗さS thを満たさないと判定されることが連続した場合、或いは、工作物Wの表面粗さの値Sが基準表面粗さS thを満たさないと判定されることが短期間に頻発した場合には、その旨を作業者に警告するための処理(エラーの表示、警告音を鳴らすなど)を行ってもよい。これにより、ツルア60等に何等かの不具合が発生した場合に、その不具合の発生を早期に発見できる。

【0047】

以上説明したように、研削盤1では、ツルーリングを実行した後に、ツルーリングが適切に実行されたか否かを判定するので、適切にツルーリングが実行されたか否かの確認を行うことができる。そして、確認の結果、ツルーリングが適切に実行されていないと判定した場合には、再度、ツルーリングを実行するための制御が実行されるので、研削不良による不良品の発生個数を少なくすることができる。30

【0048】

また、本実施の形態では、ツルーリングが良好に実行されなかった場合であっても、ツルーリング後に最初に研削される工作物Wの表面粗さの値Sが、工作物Wとして満たすべき基準表面粗さS minを満たすように、基準表面粗さS thの値が調整されている。これにより、研削不良による不良品の発生個数を少なくすることができる。

【0049】

<2. 第二実施形態>

次に、図6から図8を参照して、第二実施形態について説明する。第一実施形態では、加工後の工作物Wの表面粗さに基づき、ツルーリングが適切に実行されたか否かを判定する場合について説明した。これに対し、第二実施形態では、砥石車50による研削される接触検知ピン361の端面の表面粗さを検出、その接触検知ピン361の端面の表面粗さを検出結果に基づいて、ツルーリングが適切に実行されたか否かを判定する。なお、上記した第一実施形態と同一の部品には同一の符号を付し、その説明を省略する。40

【0050】

(2-1: 研削盤201の構成)

図6に示すように、研削盤201において、主軸台220には、砥石車50の位置を検出する位置検出装置360が設けられている。位置検出装置360は、X軸方向へ延びる50

接触検知ピン361を備える。接触検知ピン361は、砥石車50の外周面の位置を検出する部位であり、接触検知ピン361のZ軸方向を向く端面に砥石車50を接触させることで、砥石車50の位置を検出する。

【0051】

研削盤201では、ツルア60によるツルーリングを行う前及びツルーリングを行った後に、砥石車50の外周面を接触検知ピン361に接触させる。これにより、ツルーリングによる砥石車50の外径の変化、即ち、ツルーリングによる切込量を把握することができる。

【0052】

また、研削盤201では、エア供給装置90及びセンサ100が、Z軸方向において砥石車50に隣接する位置に配置される。エア供給装置90及びセンサ100は、テーブル10をZ軸方向へ移動させることにより、接触検知ピン361の端面に対向配置される。研削盤201では、ツルーリング前に砥石車50の外周面に接触した接触検知ピン361の端面の表面粗さをセンサ100により検出し、その検出結果に基づき、判定部132による判定を行う。

【0053】

なお、図7に示すように、本実施形態では、接触検知ピン361の端面の表面粗さの値Sが予め定めた基準表面粗さSthよりも大きい場合に、ツルーリングが適切に実行されたと判定する。この点において、工作物Wの表面粗さの値Sが、基準表面粗さSthよりも小さい場合に、ツルーリングが適切に実行されたと判定する第一実施形態とは異なる。

【0054】

(2-2:センサ100による検出を行う際の流れ)

次に、図6を参照して、センサ100による検出を行う際の流れを説明する。砥石車50に対するツルーリングが終了した後、砥石車50の外周面が接触検知ピン361の端面と対向する位置までテーブル10をZ軸方向へ移動させる。次に、砥石台40をX軸方向へ移動させることにより、砥石車50の外周面を接触検知ピン361に接触させる。

【0055】

次に、接触検知ピン361の端面がセンサ100と対向する位置までテーブル10をZ軸方向へ移動させた後、センサ100により接触検知ピン361の端面の表面粗さを検出する。なお、接触検知ピン361に対向する位置からセンサ100に対向するまで砥石車50を移動させる過程で、接触検知ピン361は、エア供給装置90の前を通過する。このとき、エア供給装置90は、エア吹付部91からエアを接触検知ピン361の端面に向けて吹付け、エアを接触検知ピン361の端面の付着物を吹き飛ばす。これにより、センサ100により接触検知ピン361の端面の表面粗さを検出するにあたり、その検出精度を高めることができる。

【0056】

なお、接触検知ピン361の端面とセンサ100とを対向させた状態では、砥石車50の外周面は、主軸台220及び心押台30に支持された工作物Wに対向する。よって、センサ100により接触検知ピン361の端面のセンシングを実行している間、砥石車50をX軸方向への移動を開始してもよい。

【0057】

また、センサ100による接触検知ピン361の端面のセンシングを、砥石車50による工作物Wの研削加工と並行して行ってもよい。この場合、センサ100による接触検知ピン361の端面のセンシングが終了するまで、砥石車50による工作物Wの研削加工を中断する必要がなくなる。よって、工作物Wの研削加工を行うにあたり、その加工効率の向上を図ることができる。なお、この場合において、接触検知ピン361の端面の表面粗さが良好でないと判定された場合には、研削中の工作物Wの研削加工が終了した後に、再度、ツルーリングを実行する。

【0058】

このように、本実施形態では、砥石車50の外径を測定する際に使用する接触検知ピン

10

20

30

40

50

361を、ツルーリングが適切に実行されたか否かの判定にも使用する。この場合、接触検知ピン361とは別の部品をテーブル10上に設け、その部品に砥石車50を接触させた後にセンサ100によるセンシングを行う場合と比べて、テーブル10の移動回数及び移動量を少なくすることができる。よって、工作物Wの研削加工が終了してから次の工作物Wの研削加工を開始するまでの時間の短縮を図ることができる。

【0059】

なお、研削盤201では、エア供給装置90及びセンサ100は、Z軸方向において隣接した位置に設けられ、センサ100と砥石車50との間にエア供給装置90が配置されている。このように、接触検知ピン361の端面の表面粗さを検出し、その検出結果に基づいて再度のツルーリングの要否を判定するようにすることで、工作物Wの研削加工中に飛散するクーラント等が付着しにくい位置に、センサ100を配置することができる。よって、センサ100による表面粗さの検出精度を維持することができる。10

【0060】

(2-3:ツルーリング制御部330での処理)

次に、図8を参照して、ツルーリング制御部330により実行されるツルーリング処理2について説明する。図8に示すように、ツルーリング処理2ではまず、ツルーリング実行の指示があったか否かを判定する(S1)。S1の処理において、ツルーリング実行の指示がなければ(S1:No)、S1の処理に戻る。これに対し、ツルーリング実行の指示があれば(S1:Yes)、ツルーリング実行部131によるツルーリング実行処理が開始される(S2)。20

【0061】

このS2の処理が終了した後、砥石車50の外周面を接触検知ピン361に接触させ、砥石車50の外径を計測する(S203)。その後、センサ100に対し、砥石車50により研削された接触検知ピン361の端面のセンシング実行を指示する(S204)。

【0062】

その後、センサ100から検出結果を受信したか否かの判定を行い(S5)、受信していない場合には(S5:No)、S5の処理へ戻る。一方、センサから100から検出結果を受信した場合には(S5:Yes)、判定部132による判定処理、即ち、接触検知ピン361の端面の表面粗さの値Sが、基準表面粗さSthを満たすか否かを判定する処理が実行される(S206)。30

【0063】

S206の処理の結果、接触検知ピン361の表面粗さの値Sが基準表面粗さSthを満たすと判定した場合には(S206:Yes)、ツルーリングが適切に実行されたと判断できる。よってこの場合には、そのまま本処理を終了する。一方、S206の処理の結果、接触検知ピン361の表面粗さの値がS基準表面粗さSthを満たさないと判定した場合には(S206:No)、ツルーリングが適切に実行されなかつたと判断できる。よって、この場合には、S2の処理へ戻り、再度、ツルーリングを実行する。

【0064】

<3. その他>

以上、上記各実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記各形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。40

【0065】

<4. 効果>

以上説明したように、本発明を適用した研削盤1,201は、工作物Wを回転可能に支持する主軸台20,220と、工作物Wを研削する砥石車50と、砥石車50をツルーリングするツルア60と、工作物W及び砥石車50により研削された工作物W以外の対象物の何れかである研削対象物の表面粗さを検出するセンサ100と、砥石車50に対するツルーリングに関する制御を行う制御装置110,310と、を備える。制御装置110,310は、砥石車50に対するツルーリングを行った直後に研削した研削対象物の表面粗50

さ S が、予め定めた基準表面粗さ S t h に到達しているか否かを判定する判定部 132 を備える。

【0066】

この研削盤 1, 201 によれば、砥石車 50 に対するツルーアイングを行った直後に、研削した研削対象物の表面粗さ S が、予め定めた基準表面粗さ S t h に到達しているか否かを判定するので、適切にツルーアイングが実施されたか否かの確認を行うことができる。

【0067】

上記した研削盤 1, 201 において、制御装置 110, 310 は、工作物 W の表面粗さ S が基準表面粗さ S t h に到達していないと判定した場合に、砥石車 50 に対するツルーアイングを再度行うための制御を実行する。この研削盤 1, 201 によれば、研削不良による不良品の発生個数を少なくすることができます。10

【0068】

上記した研削盤 1 において、研削対象物は、砥石車 50 による研削が終了した工作物 W であり、センサ 100 は、工作物 W が主軸台 20 に支持された状態で、工作物 W の表面粗さの検出を行う。

【0069】

この研削盤 1 によれば、センサ 100 により工作物 W の表面粗さを検出した結果、再度のツルーアイングが必要であると判定された場合に、砥石車 50 に対するツルーアイングを、工作物 W の搬送と並行して行うことができる。即ち、加工後の工作物 W を別の場所へ搬送した後に工作物 W の表面粗さを検出し、その検出結果に基づいて再度のツルーアイングを行う場合と比べて、工作物 W の研削加工が終了してから次の工作物 W の研削加工を開始するまでの時間の短縮を図ることができる。20

【0070】

上記した研削盤 201 において、研削盤 201 は、砥石車 50 との接触により砥石車 50 の外径を測定する接触検知ピン 361 を備える。研削対象物は、接触検知ピン 361 であり、センサ 100 は、ツルーアイング直後に砥石車 50 に接触した接触検知ピン 361 の表面粗さを検出する。

【0071】

この研削盤 201 によれば、砥石車 50 の外径を測定する際に使用する接触検知ピン 361 を、ツルーアイングが適切に実行されたか否かの判定にも使用できる。よって、他の部品を別に設け、その部品に砥石車 50 を接触させた後にセンサ 100 によるセンシングを行う場合と比べて、工作物 W の研削加工が終了してから次の工作物 W の研削加工を開始するまでの時間の短縮を図ることができます。また、工作物の研削加工中に飛散するクーラント等の異物が付着しにくい位置に、センサ 100 を配置しやすくすることができるので、付着物に起因するセンサ 100 の検出精度の低下を抑制できる。30

【0072】

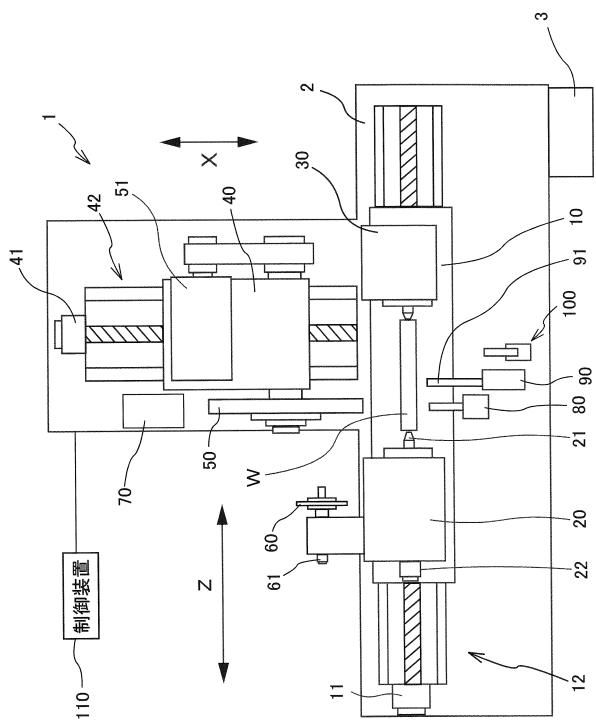
上記した研削盤 1, 201 において、センサ 100 は、基板 104 と、基板 104 上に装着され、工作物 W に向けて発光する発光素子と、基板 104 上において発光素子の近傍に装着され、工作物 W からの反射光を受光可能な第一受光素子 106 及び第二受光素子 107 としての受光素子と、受光素子の受光量に基づいて表面粗さを演算する演算部 103 と、を備える。この研削盤 1 によれば、工作物 W の表面粗さを非接触で検出することができるので、表面粗さの検出に伴って研削加工後の工作物 W に傷がつくことを回避できる。40

【符号の説明】

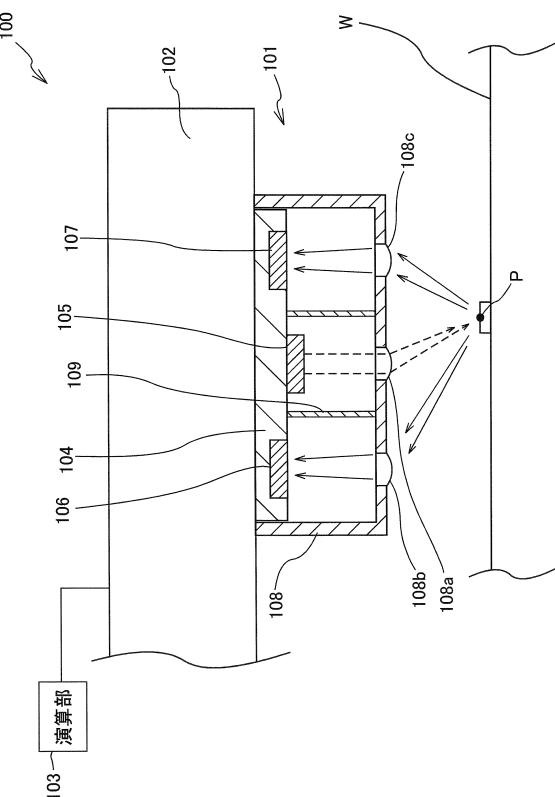
【0073】

1, 201 : 研削盤、 20, 220 : 主軸台、 50 : 砥石車、 60 : ツルア、
100 : センサ、 103 : 演算部、 104 : 基板、 105 : 発光素子、 106 :
第一受光素子(受光素子)、 107 : 第二受光素子(受光素子)、 110, 310 :
制御装置、 132 : 判定部、 361 : 接触検知ピン、 S t h : 基準表面粗さ、 W
: 工作物

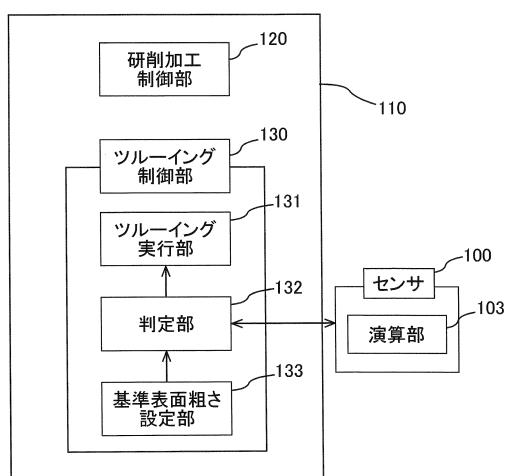
【図1】



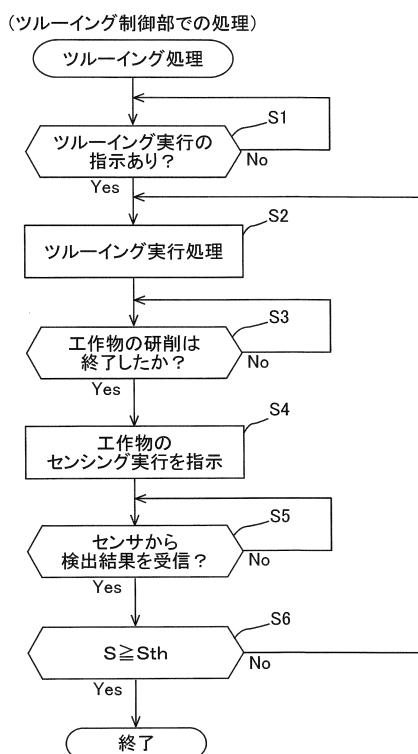
【図2】



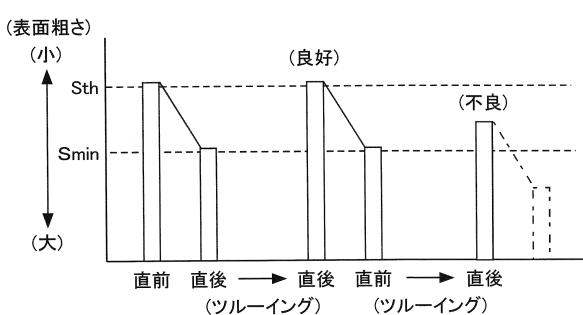
【図3】



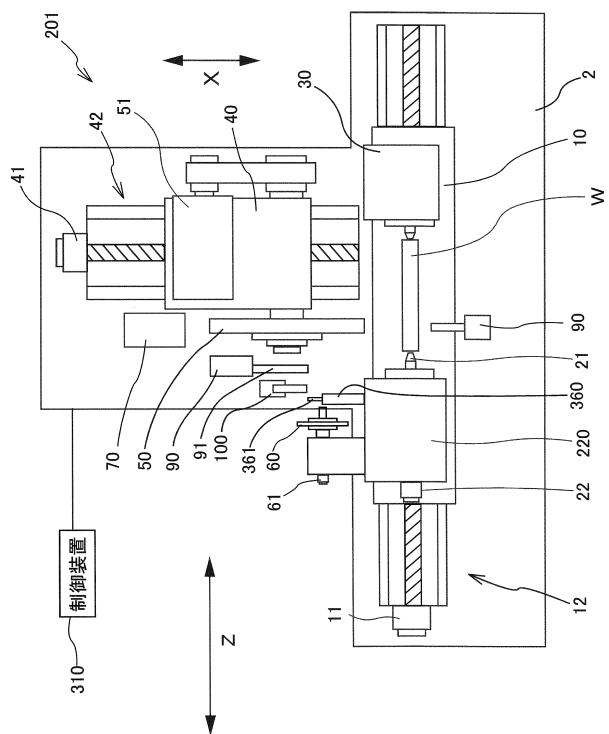
【図5】



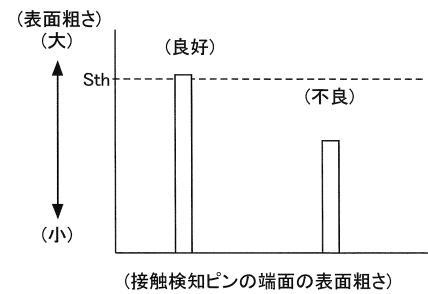
【図4】



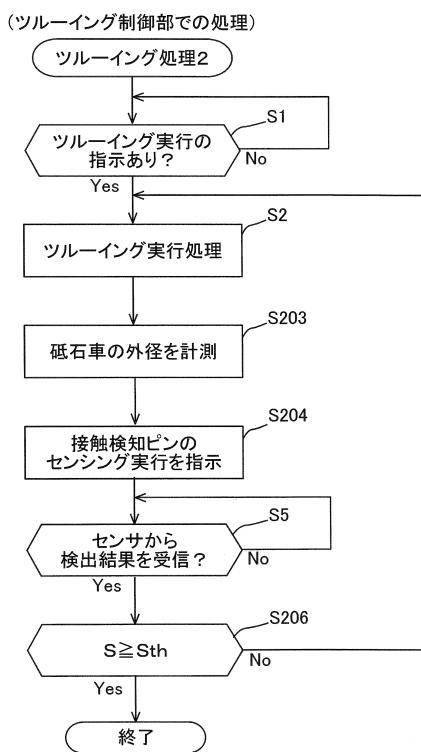
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 福田 英二
大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号 株式会社ジェイテクト内
(72)発明者 石原 光晴
大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号 株式会社ジェイテクト内

審査官 山内 康明

(56)参考文献 特開2007-196367(JP,A)
特開昭63-169267(JP,A)
特開2000-263437(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B24B 53/00
B24B 49/12
B24B 49/18
B24B 53/053
B24B 5/35